

进口金宝焊膏 BGA助焊膏 bga助焊膏

产品名称	进口金宝焊膏 BGA助焊膏 bga助焊膏
公司名称	深圳市效时实业有限公司
价格	80.00/个
规格参数	品牌:其他 型号:218 粘度:218 (Pa · S)
公司地址	深圳市宝安区福永街道兴围社区107国道西侧兴围段1号10楼
联系电话	0755-27513884 13509645670

产品详情

smt专用焊锡膏在使用过程中的常见问题

焊接后pcb板面有锡珠产生

这是在smt焊接工艺中比较常见的一个问题，特别是在使用者使用一个新的供应商产品初期，或是生产工艺不稳定时，更易产生这样的问题，经过使用客户的配合，并通我们大量的实验，我们分析产生锡珠的原因可能有以下几个方面：

- 1、pcb板在经过回流焊时预热不充分；
- 2、回流焊温度曲线设定不合理，进入焊接区前的板面温度与焊接区温度有较大差距；
- 3、焊锡膏在从冷库中取出时未能完全回复室温；
- 4、锡膏开启后过长时间暴露在空气中；
- 5、在贴片时有锡粉飞溅在pcb板面上；
- 6、印刷或搬运过程中，有油渍或水份粘到pcb板上；
- 7、焊锡膏中助焊剂本身调配不合理有不易挥发溶剂或液体添加剂或活化剂；

以上的两项原因，也能够说明为什么新更换的锡膏易产生此类的问题，其主要原因还是目前所定的温度曲线与所用的焊锡膏不匹配，这就要求客户在更换供应商时，一定要向锡膏供应商索取其锡膏所能够适应的温度曲线图；第三、第四及第六个原因有可能为使用者操作不当造成；第五个原因有可能是因为锡膏存放不当或超过保质期造成锡膏失效而引起的锡膏无粘性或粘性过低，在贴片时造成了锡粉的飞溅

；第七个原因为锡膏供应商本身的生产技术而造成的。

本产品的品牌是其他，型号是218，粘度是218 (pa · s)，颗粒度是100 (um)